

# IEEE EDAPS 2019

2019 IEEE 國際電子設計與先進封裝系統學術研討會會議

時間：2019 年 12 月 16-18 日 地點：高雄漢來大飯店

---

鈞鑒：

隨著半導體電路的不斷縮小與高速化以及無線通訊的蓬勃發展，各類電子系統及構裝結構的電氣特性設計、分析與量測，為未來系統構裝(SiPs)，三維積體電路 (3D IC)，及跨矽晶與有機多層板構裝共設計，一個相當重要且不可忽視的技術領域。我們也將探討人工智慧於電性設計的影響。

有鑒於此，國立中山大學將於 2019 年 12 月 16-18 日舉辦「2019 IEEE 國際電子設計與先進封裝系統學術研討會會議」(Electrical Design of Advanced Packaging and Systems, EDAPS 2019)。會中除了有最新的構裝技術的論文發表外，將廣邀美國、歐洲及亞洲國家重量級的學術及業界人士來台，如 Intel, IBM, IMEC 等龍頭產業的專家，以及 UIUC, GA TECH, KAIST 等國際知名學者與會，更有國內知名大廠，如台積電、日月光等參與，一同分享前瞻封裝技術。透過這一次國際會議的舉辦，可以提供國內外相關廠商與國內外學術界一個交流的平台，將台灣的關鍵性技術推展出去，國外的優質技術亦能引入，並藉以提升國內相關性技術的成長，以期達到國內外技術相互交流、產官學的相互合作研究的機會。

為使大會圓滿成功，懇請 貴公司鼎力相助，以廣告刊登等方式，共襄盛舉。謹附上贊助項目回函，敬請 貴公司填妥後回覆大會秘書處。如有任何關於經費贊助的問題，歡迎與大會財務召集主席曾昭雄教授聯繫(email: [chtseng@ieee.org](mailto:chtseng@ieee.org), tel:02-2737-6416)，謝謝您。

此 順頌  
時綏

國立中山大學電機系暨大會主席 黃立廷 教授

敬函

---

**IEEE EDAPS 2019 大會秘書處：**

康智翔先生

Tel: +886-2-23628136 ext.47 Fax: +886-2-23632090

E-mail: [kennykang@tl.ntu.edu.tw](mailto:kennykang@tl.ntu.edu.tw)

地址:106 台北市大安區基隆路 3 段 130 號 1 樓

# IEEE EDAPS 2019

## 2019 IEEE 國際電子設計與先進封裝系統學術研討會會議

時間：2019 年 12 月 16-18 日

地點：高雄漢來大飯店

EDAPS (Electrical Design of Advanced Packaging and Systems)的亞洲地區性技術報告會議，今年第十八屆會議將於高雄中山大學舉辦。此次的 EDAPS 會議，廣邀美國、日本及亞洲國家重要的學術及業界人士來台，如 Intel, IBM, Toshiba 等龍頭產業的專家，以及 UIUC, GA TECH, KAIST 等國際知名學者與會，更有國內知名大廠，如台積電、日月光等參與，一同分享前瞻構裝技術。透過這一次國際會議的舉辦，可以提供國內外相關廠商與國內外學術界一個交流的平台，將台灣的關鍵性技術推展出去，國外的優質技術亦能引入並藉以提升國內相關性技術的成長，以期達到國內外技術相互交流、產官學的相互合作研究的機會。

此次難得的國際性大型會議亦接受廠商及業界贊助，亦提供廠商邁向國際市場的機會，茲將本次會議收費標準表列如下：

### 贊助類別及享有權利：

贊助類別	金額	免費 與會名額	網頁廣告連結	參展攤 位
Platinum sponsor/ 白金級贊助	30 萬元以上 NT\$300,000 and up	5 and up	公司 LOGO 顯示於 顯著 entrance area, 會場 meeting room、Gala 晚宴、網 頁 website 及手冊 pamphlet; partial Keynote speakers and Culture event sponsors	1
Golden sponsor/ 黃金級贊助	20-30 萬元 NT\$200,000 to NT\$300,000	3 to 5	公司 LOGO 顯示於 會場 meeting room、網頁 website 及手冊 pamphlet	1
Silver sponsor/ 銀級贊助	10-20 萬元 NT\$100,000 to NT\$200,000	1 to 3	公司 LOGO 顯示於 會場 meeting room、網頁 website 及手冊 pamphlet	1
Sponsor /一般贊助	5-10 萬元 NT\$50,000 to NT\$100,000	1 to 2	感謝狀乙紙 Appreciation plaque	0

**繳費方式：**

戶名：國立台灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心

帳號：154100007959 所屬金融行號：華南銀行台大分行

■ 請以支票或匯款贊助(請於完成匯款後，將匯款憑據傳真至大會秘書處)。

**大會秘書處：**

康智翔先生

Tel: +886-2-23628136 ext.47

Fax: +886-2-23632090

E-mail: kennykang@tl.ntu.edu.tw

地址:106 台北市大安區基隆路3段130號1樓

# 2019 IEEE 國際電子設計與先進封裝系統學術研討會會議

## 贊助申請表

填單日期: 年 月 日

請勾選贊助項目：			
<input type="checkbox"/> Platinum sponsor/白金級贊助，新台幣_____元整			
<input type="checkbox"/> Golden sponsor/黃金級贊助，新台幣_____元整			
<input type="checkbox"/> Silver sponsor/銀級贊助，新台幣_____元整			
<input type="checkbox"/> Sponsor /一般贊助，新台幣_____元整			
公司中/英文名稱			
公司負責人			
地 址			
電 話		傳 真	
聯 絡 人		職 稱	
E-mail Address			
發 票 抬 頭			
統 一 編 號		<input type="checkbox"/> 二聯式 <input type="checkbox"/> 三聯式	

**感謝您對本次研討會的热情贊助!!**